



樹德科技大學

SHU-TE UNIVERSITY

臺韓國際交流甄選申請表

壹、申請人須以正楷詳細逐項填寫

中文姓名		系所班級		照片2吋	
英文姓名	(須與護照英文名一致)	學 號			
手機號碼		身分證字號			
電 話	()	護照號碼			
E-mail		出生日期	YYYY/MM/DD	國 籍	
戶籍地址				性 別	<input type="checkbox"/> 男 <input type="checkbox"/> 女
通訊地址	<input type="checkbox"/> 同戶籍地址			婚姻狀況	<input type="checkbox"/> 未 <input type="checkbox"/> 已 <input type="checkbox"/> 婚

貳、緊急聯絡人資料

姓 名		手機號碼		關 係	
通訊地址				職 業	

參、甄選條件

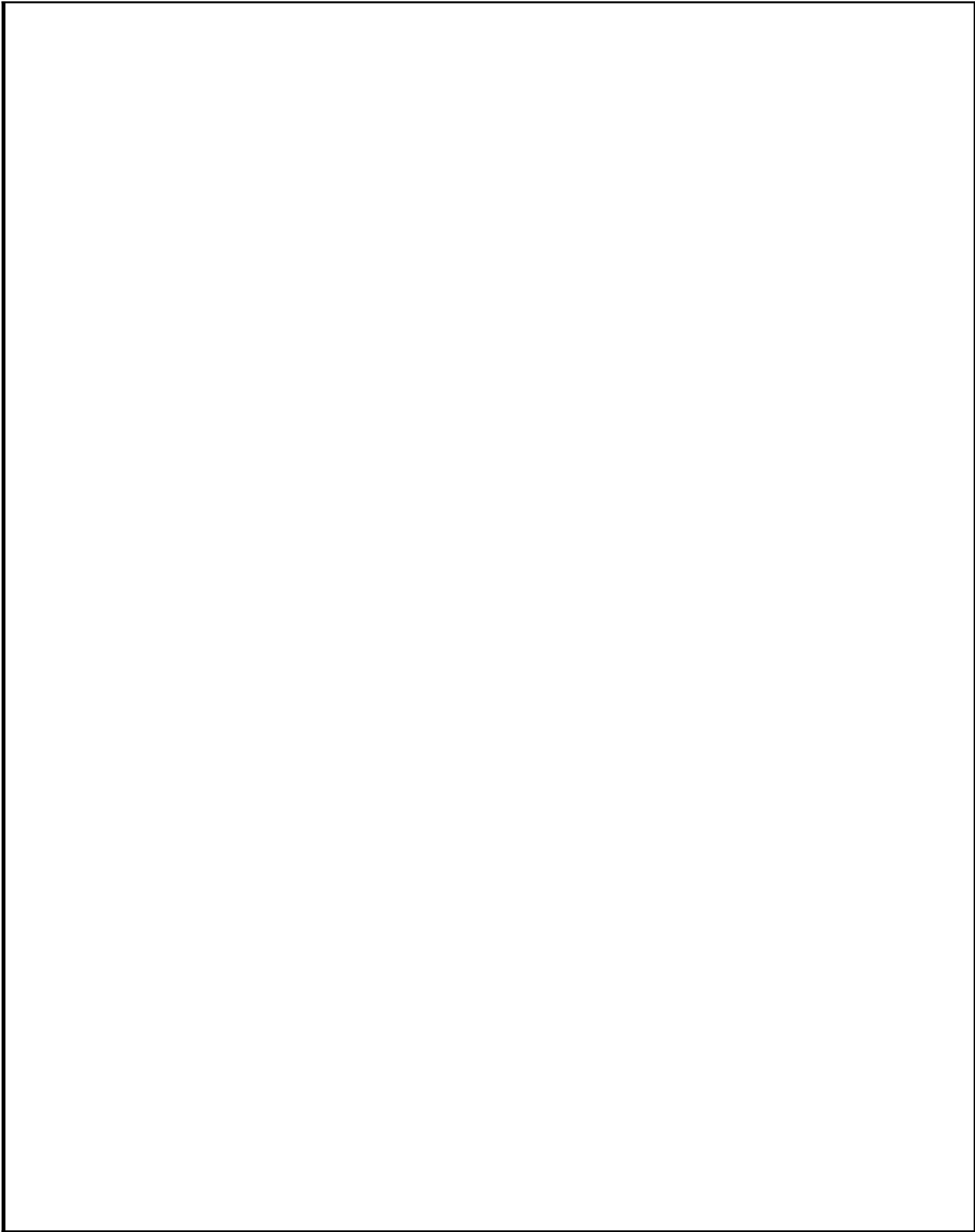
必繳文件	<input type="checkbox"/> 申請表乙份(含自傳與個人優勢表述) <input type="checkbox"/> 歷年成績單乙份(註記班上排名、學業成績及操行成績須在 70分以上)	選繳文件	<input type="checkbox"/> 英語檢定成績或證書。 <input type="checkbox"/> 其他有利審查之相關資料 _____
優先條件	是否符合優先條件： <input type="checkbox"/> 是(請續勾選下述選項，可複選)； <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 具有管理學院菁英班資格 <input type="checkbox"/> 修讀本校所開設之專業科目全英語課程，課程名稱：_____		

肆、語文能力

英文檢定	<input type="checkbox"/> 尚未參與過任何校內外英檢考試 <input type="checkbox"/> 已參與過英檢考試，測驗名稱：_____ 英檢分數：_____		
英 文	聽 <input type="checkbox"/> 優 <input type="checkbox"/> 佳 <input type="checkbox"/> 尚可 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/> 不會 說 <input type="checkbox"/> 優 <input type="checkbox"/> 佳 <input type="checkbox"/> 尚可 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/> 不會 讀 <input type="checkbox"/> 優 <input type="checkbox"/> 佳 <input type="checkbox"/> 尚可 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/> 不會 寫 <input type="checkbox"/> 優 <input type="checkbox"/> 佳 <input type="checkbox"/> 尚可 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/> 不會	其他語言	聽 <input type="checkbox"/> 優 <input type="checkbox"/> 佳 <input type="checkbox"/> 尚可 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/> 不會 說 <input type="checkbox"/> 優 <input type="checkbox"/> 佳 <input type="checkbox"/> 尚可 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/> 不會 讀 <input type="checkbox"/> 優 <input type="checkbox"/> 佳 <input type="checkbox"/> 尚可 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/> 不會 寫 <input type="checkbox"/> 優 <input type="checkbox"/> 佳 <input type="checkbox"/> 尚可 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/> 不會

自傳與個人優勢表述

--



申請人簽名

申請日期

Applicant's signature _____ Date of application _____